

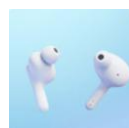
## 产品概述

该芯片是高端蓝牙音频 SoC 芯片，内置高性能DSP 和 NPU，以支持复杂的多麦克风上行降噪算法和关键字唤醒，同时兼顾低功耗。集成 Hybrid ANC，可支持高带宽、深降噪的耳机应用。可提供丰富的接口，集成度高，适用于高级 TWS 降噪耳机和其他需要复杂的音频处理和语音 AI 能力的低功耗产品。

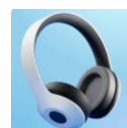
## 优势特性

- 支持BT/BLE 5.3双模协议栈；
- 高集成，内置充电、touch、佩戴、自研通话算法；
- 超低功耗，播放音乐系统功耗小于4mA；
- 高算力和AI双加持，业内首创集成高性能DSP；
- 自研人头跟踪和固定的空间音频算法，适配各种手机和音乐文件。

## 应用领域：



TWS耳机



游戏耳机

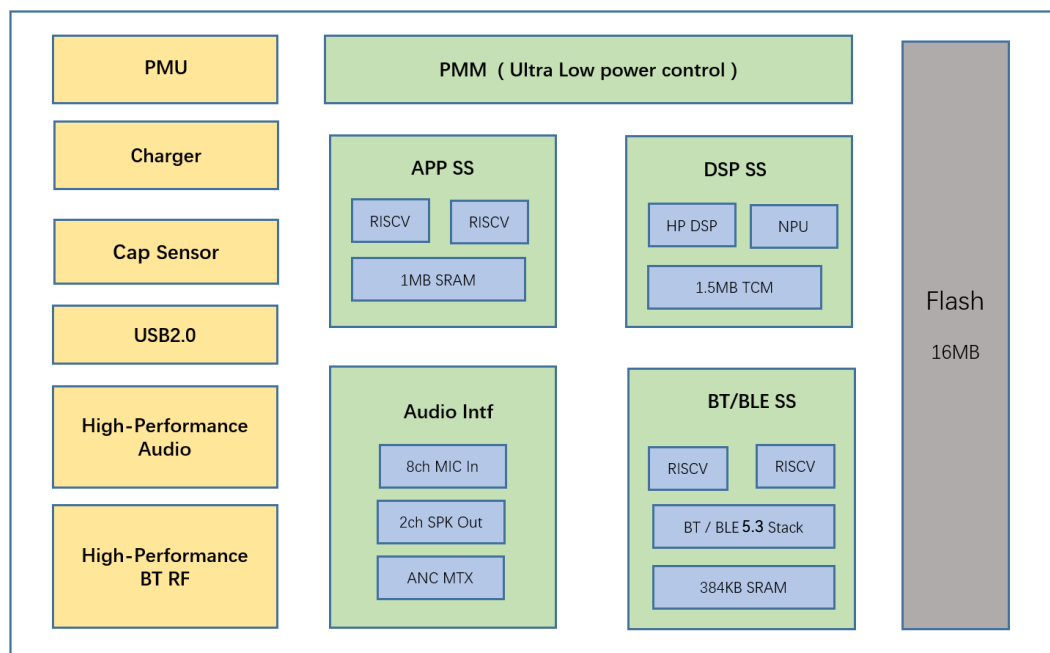


OWS耳机



蓝牙音箱

## 产品框图



### 免责声明

由于在方法、设计和制造方面的不断进步，本文档的内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，重庆物奇微电子股份有限公司对使用本文档所产生的任何错误或损害不负任何责任。